

PDP 유전체용 BaO-ZnO-B₂O₃-V₂O₅ 유리의 제조 및 특성 변화Preparation and Properties of BaO-ZnO-B₂O₃-V₂O₅ Glass for PDP Dielectric Paste

손명모, 이현수, 박재현*, 박희찬*

대구공업대학 보석귀금속과

*부산대학교 재료공학부

PDP(Plasma Display Panel)용 유전체층 재료개발에서 주요한 과제는 저온 소성용 paste 및 환경 친화적인 PbO free paste의 개발이다. 본 연구에서는 PbO free paste 제조의 일환으로 550~570°C의 소결조건에서 충분히 용착되는 BaO-ZnO-B₂O₃-V₂O₅계의 무연 프리트 유리를 개발했다.

부분 glass former인 V₂O₅와 저융점 glass former인 B₂O₃의 조성비에 따라 550°C 영역에서 회색 및 흑갈색 색상의 완전한 glass matrix를 얻을 수 있었다. V₂O₅의 조성에 따른 연화온도의 변화와 열팽창계수, 유전율 등의 변화를 조사하였다. V₂O₅와 B₂O₃의 적절한 조성영역에서 glass가 이루어지며, V₂O₅가 B₂O₃보다 너무 많으면 실투를 유발시켰다. V₂O₅, 30 wt% 첨가시료의 경우 550~560°C, 10분 이내에 충분한 용착이 되는 glass층을 얻을 수 있었다.

Enhancement of sp³ Hybridized Bonding Characteristics of Amorphous Carbon (a-C) Films by Physical Ion Bombardment and Chemical Bond Modification

Hae-Suk Jung, Hyung-Ho Park, R. Mendieta*, D. A. Smith*

Department of Ceramic Engineering, Yonsei University

*Department of Physics and Astronomy, University of Leeds, United Kingdom

We have reported a novel method of increasing sp³ hybridization fraction in sputtered amorphous carbon (a-C) film by the combination of Ar ion bombardment and Si incorporation. In the deposition of a-C films, Ar ion bombardment plays a role of creating high stress in film and causes the local bonding configuration to change to sp³ hybridized bond. Simultaneously, the incorporated Si in a-C network breaks the sp² hybridized bonded ring and promotes the formation of sp³ hybridized bond. This enhancement of sp³ hybridized bonding characteristics is maximized for a-C film with 23 at% of Si between 100 and 150 V. In this region, the increase of resistivity, optical bandgap, and mechanical hardness of a-C is attributed to the reduction of sp² hybridized bonded ring and increased fraction of sp³ hybridized bond. It is also revealed that the electronic properties of a-C are dependent on the bonding structure of sp² hybridized carbon bond as well as its fraction. However, at higher bias voltage, the enhancement effect is reduced due to the resputtering and thermally activated reconversion of sp³ to sp² hybridized bond.